

Title (en)

Method and apparatus for the thermal embossing of a substrate.

Title (de)

Verfahren und Vorrichtung zum Bedrucken eines Substrates durch Heissprägen.

Title (fr)

Méthode et appareil pour l'estampage à chaud d'un substrat.

Publication

**EP 0179977 A2 19860507 (EN)**

Application

**EP 85105800 A 19850511**

Priority

DE 3440131 A 19841102

Abstract (en)

[origin: EP0179977B1] 1. A method of printing a substrate by blind blocking, in which the substrate and a blocking-foil provided with a layer of pigment are, with the layer of pigment lying opposite the surface of the substrate which is to be printed, led together through an embossing station, in which the substrate and the blocking-foil with the application of heat become pressed together between a printing block and an impression-element, with transfer of pigments to the substrate, characterized in that at least the blocking-foil (20) is preheated before reaching the embossing station (30) and the embossing force is applied point-by-point or character-by-character serially in succession.

Abstract (de)

Für das dauerhafte Bedrucken eines Substrates mit festen und/oder variablen Daten wird ein Verfahren nebst Vorrichtung beschrieben, bei dem eine Heissprägefolie zusammen mit dem Substrat durch eine Prägestation geführt wird, in der die farbkörperfreie Oberfläche der Prägefolie in Kontakt mit einem beheizten Gegendruckelement steht und auf dem Wege zu diesem Gegendruckelement vorgeheizt wird, während die unbedruckt bleibende Oberfläche des Substrates oder die farbkörperfreie Oberfläche der Prägefolie einem Druckstock gegenüberliegt, der seinerseits unbeheizt und von einem Nadeldruckkopf oder einem Zeichendrucker gebildet ist oder einen solchen enthält.

IPC 1-7

**B41J 3/38**

IPC 8 full level

**B41J 2/325** (2006.01); **B41J 3/38** (2006.01); **B44C 1/17** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**B41J 2/325** (2013.01 - EP US); **B41J 3/38** (2013.01 - EP US); **B44C 1/1729** (2013.01 - EP US)

Cited by

DE4433054C1; EP0706890A3; EP2848413A1; EP0706890A2; WO2015134381A1

Designated contracting state (EPC)

AT CH DE FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0179977 A2 19860507**; **EP 0179977 A3 19861230**; **EP 0179977 B1 19890809**; DE 3440131 A1 19860507; DE 3440131 C2 19870402; DE 3572140 D1 19890914; US 4906316 A 19900306

DOCDB simple family (application)

**EP 85105800 A 19850511**; DE 3440131 A 19841102; DE 3572140 T 19850511; US 30994189 A 19890209